

SEMICON[®] JAPAN

岡本工作機械

セミコンジャパン2019 出展のご案内

12/11^水~13^金 東京ビッグサイト

後工程・総合ゾーン

Booth No. **2369** (West Hall 1)
に出展しています

ハイブリッド材料の総合砥粒加工提案

「技術の岡本」をスローガンに、総合砥粒加工機メーカーとして5つの提案を致します。

1 パッケージ研削

FOPLP研削におけるCu+モールド樹脂加工また、TSV研削におけるCu+Si等の異種混合材同時平坦化技術により、IoT社会の実現へ貢献します

2 次世代パワーデバイス用材料

SiC・GaN等への低ダメージ、高速加工技術と装置
UV援用高速ポリッシュ技術

3 BGテープ研削

バンブウエハーのテープ面平坦化及びバックグラインディングの無人化

4 TSV

TTV補正・汚染除去を含めたVia middle最新プロセス

5 電子部品

LT/LN等の電子部品の研削・ポリッシュ装置



<http://www.okamoto.co.jp>

Okamoto

ナノプロセス営業部 〒379-0135 群馬県安中市郷原2993 TEL: 027-385-6211 FAX: 027-385-1144